

# Twin-air<sup>®</sup> 独自の特許技術 ツインエア方式 高精細 ディスペンサ

Twin Pneumatic High-definition Liquid Dispensing System

高性能  
小型軽量ヘッド  
**400g**  
置き換えが容易

ディスペンスユニット(ライトウェイト)

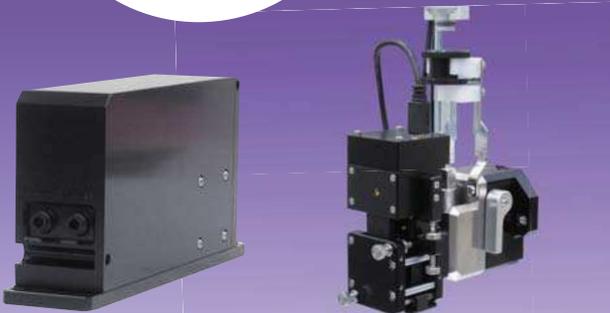
**RHL100C-2**

パターニングシステム

**LWX3000-V**

アライメント機能付パターニングシステム

**LWX3000-VA**



パルスユニット(付属品) サイドビューユニット(オプション)  
OP-SVU3-4L-USB搭載写真



コントローラ(付属品)



RHL100C-2本体



LWX3000-VA

## セルフサックバック技術で、従来のエア式の問題点を解決 液ダレ・液玉・濡れ上がり・糸引き、サテライト発生を防止

操作性...同条件では従来のディスペンサと比べてギャップが2倍以上離せる。

生産性...液ダレ・液玉・濡れ上がりを防止で清掃時間を短縮。生産性が向上。

高精度...液ダレ・液玉・濡れ上がりを防止で滴下誤差を低減。塗布精度が向上。

塗布性...独自の特許技術により超微量塗布を、エア式ディスペンサで実現。

## こんなお客様に最適

お使いのロボットのディスペンサの載せ替えへ

ダイボンダー、チップボンダーのディスペンサ交換。塗布の高性能化(極微小ドット塗布)。

お客様独自の生産設備へ搭載。微細・微小塗布を実現。

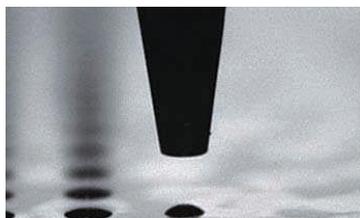
当社の塗布用3軸ロボットに搭載。高性能塗布を廉価なシステムに構成。

エスコアプリケーションシステム株式会社

**ESCO**  
エスコアプリケーションシステム株式会社

# Twin-air® Features, Applications & Specifications

## ■セルフサックバック ON/OFF



ON

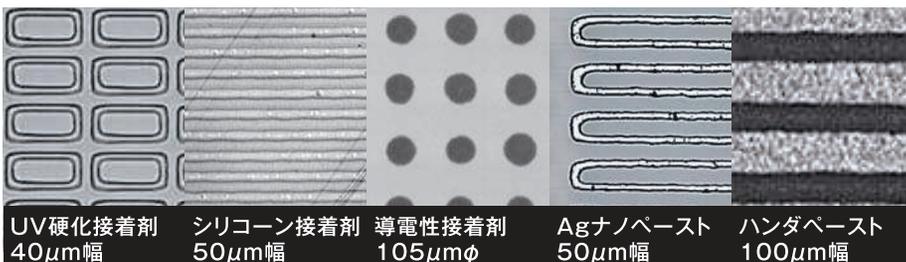
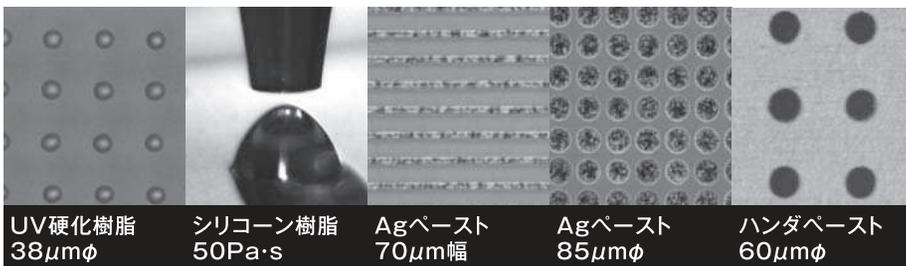
セルフサックバック機能が有効



OFF

セルフサックバック機能が無効

## ■描画・塗布アプリケーション例



主な仕様	RHL100C-2 ディスペンスユニット
吐出制御方式	ツインエア方式(特許)
ノズル	セラミック+SUS製(Twin-air®専用)
ノズル・ラインナップ (内径)	25,40,70,100,150,200 µmφ (ノズルは付属していません)
操作機器	専用コントローラのタッチパネルおよび 外部からのレシピ選択
吐出制御	外部トリガ信号またはトリガボタン押下
外形サイズ(mm)、重量	ノズルヘッド W56.4 x H133.1xD55 0.4kg バルブユニット W40 x H175 x D86 0.87kg コントローラ W320 x H149 x D230 5kg
参考:最大吐出可能粘度(注1)	1000Pa·s 以上 (100万cps以上)
参考:最小吐出可能サイズ(注1)	40µmφ以下、40µm幅以下
構成品	ノズルヘッド、バルブユニット、コントローラ、 電源ケーブル、外部制御機器接続用コネクタ、 配管用チューブ類
オプション	サイドビューユニットOP-SVU3-4L-USB (組込み型のUSB出力のカメラ搭載)

注1. 材料の物性、含有粒子や吐出環境に依存しますので、すべての材料で保証するものではありません。  
注2. 搭載オプションやホルダー、チャック形状により、有効塗布領域が狭くなる場合があります。

主な仕様	LWX3000-V,VA 塗布バナーニング装置 (RHL100C-2搭載)
ストローク(mm)	X: 320 Y:300 Z:150
最大速度(mm/s)	X,Y:600 Z:400 (可搬重量で制限あり)
搭載可能基板サイズ	最大300×300mm、t=5mm(注2)
基台	平面度5µm、M4ネジで取付
繰り返し位置決め精度	X,Y,Z:±7µm以内
制御方式	専用コントローラ制御 + GUI画面操作 または操作ペンダント(オプション)
制御方法	外部PC接続、操作ペンダント(オプション)
基板固定方法	お客様による (ホルダー製作のカスタム対応可能)
プログラム数	最大999プログラムを専用コマンドで作成可能。 最大32000ポイントを専用ソフトで設定
外形サイズ(mm)、 W×D×H 突起部含まず 重量	LWX3000-V:600×595×660 LWX3000-VA:670×605×660 50kg以下
構成品	RHL100C-2一式、XYZ三軸ロボット、 制御用ノートPC、サイドビューユニットOP- SVU3-4L-USB、設定ソフトウェア、 ノズルピース(5本入り)
オプション	操作ペンダント、塗布動作基本プログラム作成、 安全カバー、基板吸着テーブル、 真空ポンプ、保守部品サービスセット等

販売  
代理店



株式会社 日本レーザー

http://www.japanlaser.co.jp | mail to: proc@japanlaser.jp

東京本社 東京都新宿区西早稲田2-14-1  
TEL 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860

大阪支店 大阪市東淀川区東中島1-20-12  
TEL 06-6323-7286 FAX 06-6323-7283

名古屋支店 名古屋市中区錦3-1-30  
TEL 052-205-9711 FAX 052-205-9713

デモ・評価・試作等を承っておりますので、お気軽にお問合せください。

エンジニアリングシステム株式会社  
http://www.engineeringsystem.co.jp



〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-83  
TEL 0263-26-1212 FAX 0263-26-1213  
E-mail: sales@engineeringsystem.co.jp